**#**

|  |  |
| --- | --- |
| **Leserkontakt:** | **Pressekontakt:** |
| **congatec AG** | **SAMS Network**  |
| Christian Eder | Michael Hennen |
| Telefon: +49-991-2700-0 | Telefon: +49-2405-4526720 |
| info@congatec.com [www.congatec.com](http://www.congatec.com)  | info@sams-network.com [www.sams-network.com](http://www.sams-network.com)  |

**

*Text und Foto verfügbar:* [*https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html*](https://www.congatec.com/de/congatec/pressemitteilungen.html)

Pressemitteilung

10 neue High-End Module von congatec für das Embedded Edge Computing

**Das neueste und beste von Intel®**

**Deggendorf, 17. Juli 2019 \* \* \*** congatec – ein führender Anbieter von standardisierten und kundenspezifischen Embedded Computer Boards und Modulen – hat heute 10 neue COM Express Type 6 Module mit Intels aktuell neuester und bester Embedded Prozessortechnologie vorgestellt. Die vier Intel® Xeon®, drei Intel® Core™, zwei Intel® Celeron® und ein Intel® Pentium® Prozessoren basieren alle auf derselben Intel Mikroarchitektur (Codename Coffee Lake H). Dadurch kann congatec alle 10 neuen Prozessoren auf Basis eines einzigen COM Express Modul Designs – dem conga-TS370 – verfügbar machen. Insgesamt sind nun 14 Prozessormodulvarianten mit einer einzigen Mikroarchitektur verfügbar, die eine extrem weite Skalierbarkeit bieten. Speerspitze in punkto Rechenleistung ist dabei das 45 Watt 6-Core-Modul mit 2,8 GHz Intel® Xeon® Prozessor E-2276ME. Es bietet aktuell die höchste weltweit verfügbare Embedded Rechenperformance mit prozessorintegrierter Hochleistungsgrafik. Das 2,4 GHz Intel® Celeron™ Prozessor G4930E Modul mit 35 Watt stellt zudem den neuen Preis-Performance Benchmark auf.

Besonders hervorzuheben sind die beiden 6-Core-Module, die mit einer TDP von lediglich 25 Watt, die congatec auf Basis der Intel® Xeon® E-2276ML und Intel® Core™ i7-9850HL Prozessoren anbietet. Sie ermöglichen Entwicklern komplett passiv gekühlte Embedded Edge Computing Systeme aufzusetzen, die dank Hyperthreading parallel bis zu 12 eigenständige virtuelle Maschinen betreiben können. Dadurch lassen sie sich selbst in voll versiegelten Systemen unter rauesten Umgebungsbedingungen mit höchsten IP Schutzarten betreiben. Gleiches gilt auch für die beiden Quadcore-Module mit Intel® Xeon® E-2254ML oder Intel® Core™ i3-9100HL Prozessor sowie für das Intel® Celeron® G4932E Prozessor basierte Modul, die alle ebenfalls eine – teils konfigurierbare – TDP von 25 Watt aufweisen.

„Im Embedded Edge Computing Segment konsolidieren unsere OEM Kunden auf solchen Multicore-Plattformen mehrere vormals separate Systeme nun auf einem einzigen Embedded Edge Computer. Mit Hypervisor-Technologie können sie bis zu 12 virtuelle Maschinen parallel auf einem System betreiben“, erklärt Andreas Bergbauer, Product Line Manager für COM Express Module bei congatec. „Das sind beispielsweise Echtzeitsteuerungen (Soft-SPSen), Industrie 4.0 Gateways für taktiles Internet über Time Synchronized Networking, IoT-Gateways für das Senden von Big Data in Richtung Cloud und zentrale Managementsysteme sowie Vision Systeme, künstliche Intelligenz (KI) und Deep-Learning-Applikationen. Hinzu kommen auch Software-Defined-Networking-Funktionen wie Intrusion Prevention und Detection Systeme, die den Datenverkehr parallel zu den Applikationen analysieren und so Latenzen vermeiden, die bei seriellem Betrieb von Analytik und Applikation entstehen würden.“

Weitere Anwendungsfälle neben dem Embedded Edge Computing sind selbstverständlich auch klassische High-End Medical Imaging Systeme und HMIs sowie High-End-Gaming-, Infotainment- und Digital Signage Systeme, die Best-in-Class Rechenleistung und Durchsatz in Kombination mit Intel Grafiktechnologie auf einem einzigen Die erfordern.

conga-TS370 COM Express Type 6 Computer-on-Modules können ab sofort in folgenden Standardkonfigurationen bestellt werden:

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | **Prozessor** |  | **Cores/Threads** |  | **Takt [GHz] (Base/Boost)**  |  | **Cache (MB)**  |  | **TDP / cTDP [W]**  |
| **Neu** |  | Intel® Xeon®E-2276ME  |  | 6 / 12 |  | 2,8 / 4,5 |  | 12 |  | 45 / 35 |
|  |  | Intel® Xeon® E-2176M |  | 6 / 12 |  | 2,7 / 4,4 |  | 12 |  | 45 / 35 |
| **Neu** |  | Intel® Xeon® E-2276ML |  | 6 / 12 |  | 2,0 / 2,4 |  | 12 |  | 25 |
| **Neu** |  | Intel® Core™ i7-9850H |  | 6 / 12 |  | 2,7 / 4,4 |  | 9 |  | 45 / 35 |
|  |  | Intel® Core™ i7-8850H |  | 6 / 12 |  | 2,6 / 4,3 |  | 9 |  | 45 / 35 |
| **Neu** |  | Intel® Xeon® E-2254ME |  | 4 / 8 |  | 2,6 / 3,8 |  | 8 |  | 45 / 35 |
| **Neu** |  | Intel® Core™ i7-9850HL |  | 6 / 12 |  | 1,9 / 4,1 |  | 9 |  | 25 |
|  |  | Intel® Core™ i5-8400H |  | 4 / 8 |  | 2,5 / 4,2 |  | 8 |  | 45 / 35 |
|  |  | Intel® Core™ i3-8100H |  | 4 / 4 |  | 3.0 / 2,6 |  | 6 |  | 45 / 35 |
| **Neu** |  | Intel® Xeon® E-2254ML |  | 4 / 8 |  | 1,7 / 3,5 |  | 8 |  | 25 |
| **Neu** |  | Intel® Core™ i3-9100HL |  | 4 /4 |  | 1,6 / 2,9 |  | 6 |  | 25 |
| **Neu** |  | Intel® Pentium® Gold 5600E |  | 2 / 2 |  | 2,6 / 3,1 |  | 4 |  | 35 |
| **Neu** |  | Intel® Celeron® G4930E |  | 2 / 2 |  | 2,4 / 2,4 |  | 2 |  | 35 |
| **Neu** |  | Intel® Celeron® G4932E |  | 2 / 2 |  | 1,9 / 1,9 |  | 2 |  | 25 |

Alle Angaben zum umfassenden Featureset der conga-TS370 COM Express Type 6 Computer-on-Module finden Sie unter: <https://www.congatec.com/de/produkte/com-express-type-6/conga-ts370.html>

**Über congatec**

congatec ist ein führender Anbieter von industriellen Computermodulen auf den Standard-Formfaktoren COM Express, Qseven und SMARC sowie für Single Board Computer und Customizing-Services. Die Produkte und Dienstleistungen des innovativen Unternehmens sind branchenunabhängig und werden z.B. in der Industrie-Automatisierung, der Medizintechnik, im Entertainment, im Transportwesen, bei Telekommunikation, Test & Measurement sowie Point-of-Sale Anwendungen eingesetzt. Wesentliche Kernkompetenz und technisches Know-How sind besondere, erweiterte BIOS Features sowie umfangreiche Treiberunterstützung und Board Support Packages. Die Kunden werden ab der Design-In Phase durch umfassendes Product Lifecycle Management betreut. Die Fertigung der Produkte erfolgt bei spezialisierten Dienstleistern nach modernsten Qualitätsstandards. congatec mit Hauptsitz in Deggendorf, Deutschland unterhält Niederlassungen in den USA, Taiwan, China, Japan und Australien sowie in Großbritannien, Frankreich und Tschechien. Weitere Informationen finden Sie unter [www.congatec.de](http://www.congatec.de/) oder bei [Facebook](http://www.facebook.com/Congatec), [Twitter](https://mobile.twitter.com/congatecAG) und [YouTube](http://www.youtube.com/congatecAE).

\* \* \*

*Intel, Core, Xeon, Pentium und Celeron sind Handelsmarken oder eingetragene Warenzeichen der Intel Corporation in den USA und anderen Ländern.*